

中国半导体硅片行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国半导体硅片行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202204/588627.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

半导体硅片又称硅晶圆片，是制作集成电路的重要材料，通过对硅片进行光刻、离子注入等手段，可以制成集成电路和各种半导体器件。分类来看，半导体硅片按其直径划分，主要可分为6英寸、8英寸、12英寸及18英寸等，目前市场上主要为直径12英寸及以下规格，18英寸则还在研发中。

资料来源：公开资料整理

半导体硅片是半导体产业链的上游，是制作芯片的核心材料，贯穿了芯片制作的全过程，半导体硅片的质量和数量不仅是我国制造芯片的关键材料，同时也是制约我国下游终端领域行业的发展。

1、终端需求旺盛，政策利好，市场规模快速增长

半导体硅片是半导体行业最重要的原材料，在硅基板上的生产的半导体器件应用于各种消费电子产品、汽车电子及工业控制领域。从终端应用市场来看，当前8英寸晶圆下游主要应用领域为汽车、工业、智能手机、白色家电、IoT等；12英寸晶圆下游主要应用领域为智能手机、PC、平板电脑、服务器、游戏、汽车、工业等。

我国不同规格半导体硅片终端应用市场规模占比情况

产品规格分类

终端应用市场规模占比（%）

8英寸半导体硅片

汽车领域：33%

工业领域：27%

智能手机领域：19%

12英寸半导体硅片

智能手机领域：32%

PC领域：20%

服务器：18%

资料来源：观研天下整理

当前，我国5G手机、汽车电动化、ADAS、以及数据中心等行业发展较好且前景明朗，带动着我国半导体行业需求结构性改善；5G、远程办公等数字化需求使得我国的数据量发生爆炸式增长，从而带动着国内半导体硅片需求的增长。

除此之外，近年来国家层面对于新材料、半导体等领域也陆续出台了多项支持性政策，因此我国半导体硅片行业的政策环境也持续向好。

2019-2021年我国半导体硅片行业相关政策 时间 部分 政策名称 相关内容 2020年12月

财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部

关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告 国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税；国家鼓励的集成电路线宽小于65纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税；国家鼓励的集成电路线宽小于130纳米（含），且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。 2020年7月 国务院

新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策 国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件由工业和信息化部会同相关部门制定。 2020年5月

财政部、税务总局

关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告 依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。 2019年11月 工信部

重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版） 包括半导体、集成电路、钢铁材料、铜材、铝材料、钛材、先进化工材料、膜材料以及先进无机非金属材料等。 2019年10月

国家发改委 产业结构调整指导目录（2019年本） 半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料，依然属于国家鼓励类产业之一。 2019年3月 国务院 2019年政府工作报告 促进新兴产业加快发展。

深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。 2021年3月 十三届全国人大四次会议

中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 集中优势资源攻关核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管等特色工艺突破，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。

资料来源：观研天下整理

在终端需求旺盛，政策环境向好的背景下，我国硅片产量逐年上升，半导体硅片市场规模快速增长。

资料来源：中国光伏行业协会

资料来源：观研天下整理

2、12英寸为主流产品，但国内自给率较低

产品方面来看，当前12英寸为市场主流产品。根据数据显示，2021年我国12英寸硅片出货面积占比已超过60%。一方面，12寸硅片面积为8寸硅片的2.25倍，相较于8寸，12寸晶圆单位面积成本将改善20%-30%；另一方面，行业下游需求也更加偏好12寸硅片，其中逻辑芯片和存储是12寸硅片需求增长主要驱动力。终端应用领域上，智能手机和数据中心是12英寸硅片需求的两个最大来源。

我国不同尺寸半导体硅片应用领域及应用占比情况

产品规格分类	应用领域	占比(%)
12英寸	逻辑芯片、记忆芯片领域	60%-70%
8英寸	集成电路、芯片、工艺电子元器件领域	20-30%
6英寸及以下	普通消费电子元器件领域	10%以下

资料来源：观研天下整理

3、行业壁垒较高，海外厂商占据国内市场主导

12寸硅片基本采用300nm半导体硅片制造技术。在半导体硅片行业，我国企业目前主要面临着四大壁垒：技术壁垒，认证壁垒，设备壁垒和资金壁垒。

资料来源：观研天下整理

当前，由于半导体硅片行业有着较高的壁垒，因此目前我国半导体硅片市场集中度极高，且前五大半导体硅片制造商市场份额高达92%，市场份额主要由外资企业占据。国内半导体硅片龙头企业沪硅产业、中环股份、立昂微、中晶科技的半导体硅片市场份额合计不到35%。

资料来源：观研天下整理

全球范围来看，当前半导体硅片市场处于垄断格局，其中日本厂商日本信越化学和Sumco合计市场份额超过50%，在半导体研发和材料行业中也一直处于领先地位。

资料来源：公开资料整理

4、应用领域不断拓展，大尺寸国产化成为主趋势

未来，我国半导体硅片行业产品大尺寸国产化将成为主趋势。一方面行业终端应用领域不断拓展，远程办公、线上会议、汽车自动驾驶、元宇宙等新需求推动12英寸半导体硅片需求的增加。

另一方面，半导体行业呈现明显周期性变化，行业周期约为3-5年，而当前我国半导体硅片正处于行业周期受益期。而且，随着国内自建晶圆厂快速扩产，上游的设备和材料急需提升国产化率。目前以沪硅产业、立昂微、中环股份等为代表的厂商已逐步突破12英寸半导体硅片，此外神工股份、上海超硅、中晶科技、有研半导体等在硅材料各领域也有突破，未来我国半导体硅片大尺寸国产化进程也将逐步加快。（LQM）

观研报告网发布的《中国半导体硅片行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2018-2022年中国半导体硅片行业发展概述

第一节 半导体硅片行业发展情况概述

一、半导体硅片行业相关定义

二、半导体硅片特点分析

三、半导体硅片行业基本情况介绍

四、半导体硅片行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、半导体硅片行业需求主体分析

第二节中国半导体硅片行业生命周期分析

- 一、半导体硅片行业生命周期理论概述
- 二、半导体硅片行业所属的生命周期分析

第三节半导体硅片行业经济指标分析

- 一、半导体硅片行业的赢利性分析
- 二、半导体硅片行业的经济周期分析
- 三、半导体硅片行业附加值的提升空间分析

第二章 2018-2022年全球半导体硅片行业市场发展现状分析

第一节全球半导体硅片行业发展历程回顾

第二节全球半导体硅片行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲半导体硅片行业地区市场分析

- 一、亚洲半导体硅片行业市场现状分析
- 二、亚洲半导体硅片行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲半导体硅片行业市场前景分析

第四节北美半导体硅片行业地区市场分析

- 一、北美半导体硅片行业市场现状分析
- 二、北美半导体硅片行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美半导体硅片行业市场前景分析

第五节欧洲半导体硅片行业地区市场分析

- 一、欧洲半导体硅片行业市场现状分析
- 二、欧洲半导体硅片行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲半导体硅片行业市场前景分析

第六节 2022-2029年世界半导体硅片行业分布走势预测

第七节 2022-2029年全球半导体硅片行业市场规模预测

第三章 中国半导体硅片行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品零售总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节我国宏观经济环境对半导体硅片行业的影响分析

第三节中国半导体硅片行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对半导体硅片行业的影响分析

第五节中国半导体硅片行业产业社会环境分析

第四章 中国半导体硅片行业运行情况

第一节中国半导体硅片行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国半导体硅片行业市场规模分析

一、影响中国半导体硅片行业市场规模的因素

二、中国半导体硅片行业市场规模

三、中国半导体硅片行业市场规模解析

第三节中国半导体硅片行业供应情况分析

一、中国半导体硅片行业供应规模

二、中国半导体硅片行业供应特点

第四节中国半导体硅片行业需求情况分析

一、中国半导体硅片行业需求规模

二、中国半导体硅片行业需求特点

第五节中国半导体硅片行业供需平衡分析

第五章 中国半导体硅片行业产业链和细分市场分析

第一节中国半导体硅片行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、半导体硅片行业产业链图解

第二节中国半导体硅片行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对半导体硅片行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对半导体硅片行业的影响分析

第三节我国半导体硅片行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2018-2022年中国半导体硅片行业市场竞争分析

第一节中国半导体硅片行业竞争现状分析

一、中国半导体硅片行业竞争格局分析

二、中国半导体硅片行业主要品牌分析

第二节中国半导体硅片行业集中度分析

一、中国半导体硅片行业市场集中度影响因素分析

二、中国半导体硅片行业市场集中度分析

第三节中国半导体硅片行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2018-2022年中国半导体硅片行业模型分析

第一节中国半导体硅片行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节中国半导体硅片行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国半导体硅片行业SWOT分析结论

第三节中国半导体硅片行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

- 二、政策因素
- 三、经济因素
- 四、社会因素
- 五、技术因素
- 六、PEST模型分析结论

第八章 2018-2022年中国半导体硅片行业需求特点与动态分析

第一节中国半导体硅片行业市场动态情况

第二节中国半导体硅片行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节半导体硅片行业成本结构分析

第四节半导体硅片行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、其他因素

第五节中国半导体硅片行业价格现状分析

第六节中国半导体硅片行业平均价格走势预测

- 一、中国半导体硅片行业平均价格趋势分析
- 二、中国半导体硅片行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国半导体硅片行业所属行业运行数据监测

第一节中国半导体硅片行业所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

第二节中国半导体硅片行业所属行业产销与费用分析

- 一、流动资产
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析
- 四、利润规模分析
- 五、产值分析

第三节中国半导体硅片行业所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析

- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第十章 2018-2022年中国半导体硅片行业区域市场现状分析

第一节 中国半导体硅片行业区域市场规模分析

- 一、影响半导体硅片行业区域市场分布的因素
- 二、中国半导体硅片行业区域市场分布

第二节 中国华东地区半导体硅片行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区半导体硅片行业市场分析
 - (1) 华东地区半导体硅片行业市场规模
 - (2) 华东地区半导体硅片行业市场现状
 - (3) 华东地区半导体硅片行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区半导体硅片行业市场分析
 - (1) 华中地区半导体硅片行业市场规模
 - (2) 华中地区半导体硅片行业市场现状
 - (3) 华中地区半导体硅片行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区半导体硅片行业市场分析
 - (1) 华南地区半导体硅片行业市场规模
 - (2) 华南地区半导体硅片行业市场现状
 - (3) 华南地区半导体硅片行业市场规模预测

第五节 华北地区半导体硅片行业市场分析

- 一、华北地区概述
- 二、华北地区经济环境分析
- 三、华北地区半导体硅片行业市场分析
 - (1) 华北地区半导体硅片行业市场规模
 - (2) 华北地区半导体硅片行业市场现状

(3) 华北地区半导体硅片行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区半导体硅片行业市场分析

(1) 东北地区半导体硅片行业市场规模

(2) 东北地区半导体硅片行业市场现状

(3) 东北地区半导体硅片行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区半导体硅片行业市场分析

(1) 西南地区半导体硅片行业市场规模

(2) 西南地区半导体硅片行业市场现状

(3) 西南地区半导体硅片行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区半导体硅片行业市场分析

(1) 西北地区半导体硅片行业市场规模

(2) 西北地区半导体硅片行业市场现状

(3) 西北地区半导体硅片行业市场规模预测

第十一章 半导体硅片行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第三节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第四节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第五节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第六节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

.....

第十二章 2022-2029年中国半导体硅片行业发展前景分析与预测

第一节中国半导体硅片行业未来发展前景分析

- 一、半导体硅片行业国内投资环境分析
- 二、中国半导体硅片行业市场机会分析
- 三、中国半导体硅片行业投资增速预测

第二节中国半导体硅片行业未来发展趋势预测

第三节中国半导体硅片行业规模发展预测

- 一、中国半导体硅片行业市场规模预测
- 二、中国半导体硅片行业市场规模增速预测

三、中国半导体硅片行业产值规模预测

四、中国半导体硅片行业产值增速预测

五、中国半导体硅片行业供需情况预测

第四节中国半导体硅片行业盈利走势预测

第十三章 2022-2029年中国半导体硅片行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国半导体硅片行业进入壁垒分析

一、半导体硅片行业资金壁垒分析

二、半导体硅片行业技术壁垒分析

三、半导体硅片行业人才壁垒分析

四、半导体硅片行业品牌壁垒分析

五、半导体硅片行业其他壁垒分析

第二节半导体硅片行业风险分析

一、半导体硅片行业宏观环境风险

二、半导体硅片行业技术风险

三、半导体硅片行业竞争风险

四、半导体硅片行业其他风险

第三节中国半导体硅片行业存在的问题

第四节中国半导体硅片行业解决问题的策略分析

第十四章 2022-2029年中国半导体硅片行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国半导体硅片行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国半导体硅片行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 半导体硅片行业营销策略分析

一、半导体硅片行业产品策略

二、半导体硅片行业定价策略

三、半导体硅片行业渠道策略

四、半导体硅片行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202204/588627.html>